申込締切

2025年5月20日

※本申込書のコピーをとり、必ず控としてください。

出展規定を了承し、下記のとおり			年	月	日
会社名(和文) ふりがな					
				印	
会社名(英文)					
□ 主催者会員/□ 非会員					
※共同出展社のある場合、下記に	ご記入ください。ただし連絡先は原則とし	して 1 社となります。			
会社名(和文) ふりがな	(英文)				
□ 主催者会員/□ 非会員					
会社名(和文) ふりがな	(英文)				
□ 主催者会員/□ 非会員					
<u>で住所</u> 〒					
Tel.					
	(和文Web)				
インターネットホームページアドレス	(英文Web)				
担当者名	担当者所	属部課名•役職名			
担当者 e-mail (必ずご記入ください。)					
出展製品					

申込書送付先:展示会事務局(株)シー・エヌ・ティ

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-24-3-4F

Tel. 03-5297-8855 Fax. 03-5294-0909 info2025@powtex.com

(社印押印後、郵送・FAXまたはメールでお送りください)

●申込小間数	_ , , , , , ,	(面開放/1~3小間出展社限定) 1・6・8小間ブロックダブル出展		きする			
	小間レイアウト □ 並列	(4小間以上の出展社のみ☑必須□ ブロックダブル		□ 独立トリプル	□対向		
	□ トライアルブー	-ス ()	小間				
	いずれかにチェッ 1) 対象分野:	体シミュレーションゾーン (かしてください。 □ 未来材料 □ 粉(シテーション: □ 希望で	本シミュレーシ		8社/発表時間は主催者で	で決定します。)	
2製品技術説明会	□(発表希望時間枠 ※複数枠をお申込み)枠 申込みます。 第一希望(いただく場合、2枠目の発表時間)) 第二者)第三希望()
		でのオンデマンド配信を申込			/11満社が受	付終了	ははま
料金						(金額は消費税	110%を含む
— <u>f</u>	投小間 小間単価 ()		金額表 (単価)	間口×奥行×高さ(m)	主催者会員	一般
+角小間	※出展小間数(・三面開放指定料()		一般小間	2.97×2.97×2.7	330,000円	396,000円
トライアル:	ブース 小間単価(396,000) × ()		角小間指定料	_	55,000円	66,000円
未来材料・粉体シミュー	レーションゾーン 小間単価 ()			_	330,000円	396,000円
	×出展小間数()		- ライアルブース	2.97×2.97×2.7	396,0	00円
	製品技術説明会 単価×枠数()×()		未来材料・	1.98×1.495×2.7	198,000円	242,000円
オンライン展での		,,,,,	粉体シ	ミュレーションゾーン	1.36 \ 1.493 \ 2.7	,	,
	単価×枠数() x ()	製品技術説明会	1枠	_	55,000円	66,000円
	合計()	加州五	オンラインでの配信 1枠	_	22,000円	33,000円
❸イチオシ!ショー□ 参加を希望する 発表④ダイレクトメー□ 和文 案内状□ 和文 封筒	長予定製品(※現時点	での発表内容を下部の出展製品 望枚数 (送付は8月下旬を	予定。希望数無 案内状		ラム作成の参考といたしま) 枚) 枚	₹ す 。	
⑤ ポスター希望枚 ()枚	数 (送付は8月下旬を 1	予定。希望数無料)					
	不要・給排	□有 □無 【有る場合	・エアー	□要□不到			
対象	ユーザー		ていただく場合が	ました個人情報は、本展の運営管理、			

出展製品			
粉粒体製造機器 □ 粉体ハンドリング	□ 造粒・コーティング・表面改質	粉粒体計測機器 □ 粒子径•粒子形状	粉体材料 □粉砕媒体

(◆切込み ◆貯槽 ◆供給 ◆輸送 ◆解袋 ◆閉塞対策 ◆周辺機器) □ 破砕・粉砕 (◆破砕 ◆粉砕 ◆微粉砕 ◆超微粉砕 ◆解砕)

□ 分級・選別・ふるい分け (◆分級 ◆ふるい分け ◆選別 ◆分離・異物除去)

□ 集じん

□晶析・乳化・溶解

□ 混合・撹拌・分散

□ 湿式処理 (◆ろ過 ◆圧搾 ◆脱水 ◆濃縮・固液分離 ◆膜分離 ◆脱泡)

□ファインバブル

□ 乾燥・冷却 □ 混錬·捏和

□ 造粒・コーティング・表面改質(◆造粒 ◆コーティング ◆表面改質 ◆整粒)

□ 成形・打錠(◆成形 ◆打錠 ◆カプセル)

□ 積層加工技術(◆積層造形 ◆積層加工技術)

□ 焼成・焼却 □包装・充填・計量

□ 計装 (◆計装 ◆サンプリング ◆制御 ◆環境測定)

□ エンジニアリング
(◆エンジニアリング ◆プラント建設・工場建設)

◆ライニング加工他)

□その他 (◆リサイクル ◆爆発安全 ◆殺菌 ◆スクリーン・金網・樹脂網 ◆ろ過布 ◆コンテナ・容器 ◆保温・断熱・防音

◆封じ込め ◆表面処理 ◆機能塗装

□その他 □ 研究室用機器・ラボ機

□シミュレーション・ソフト

□ 粒子物性

□ 粒子表面構造

□ (乾燥)粉粒体特性

□ サンプリング・縮分

□ 受託加工・受託計測

□ 粒子懸濁液特性・スラリー特性

□書籍・JIS規格・ 標準粉体

□ 分散剤

□ 機能性材料

□ 医薬品添加剤

□ 粉体材料

出展予定製品のユーザーの業種について、該当されるもの すべてにチェックしてください。

□ 化学・ゴム・プラスチック・紙・パルプ □医薬品・健康食品・化粧品

□食品・飼料

無機材料・セラミックス 鉄鋼・金属・鉱業・セメント

機械・電気・電池・エレクトロニクス □エンジニアリング・建設

□ 官公庁・学校・国公立研究機関

□ 環境・エネルギー、リサイクル □商社

□ その他 [

が適切に個人情報を取り扱うよう監督いたします。

事務局記入欄

申込受付月日	申込受付番号	受付者印

備考			